



画像処理・マシンビジョン向け産業用コンピューターの特長

ハイエンドのXeon® & 第7世代Core™ i7

高速処理を実現するXeon® E5-2600 v4 / Xeon® D-1587 / 第7世代Core™ i7等のハイエンドなプロセッサーを搭載。コア数重視ならXeon®系(デュアルCPUで最大44コア)、コストパフォーマンス重視ならCore™ i7系と用途あわせてお選びいただけます。



高速化したDDR4メモリー

DDR4世代メモリーを装備し、メモリー転送性能において従来のDDR3と比べて約146%も向上。SSDやM.2など高速ストレージと組み合わせることで、システム全体の処理性能を高めることが可能です。

DDR4 vs DDR3
DDR4 約146%UP
※当社調べ。総合ベンチマークツール「Sandra」を使用。

動作検証済みのDIOボードを標準搭載

ラックマウントタイプやタワータイプの産業用コンピューターには、動作検証済みのDIO(デジタル入出力)ボードをモデルにより標準搭載。

手間のかかる動作検証や不具合を気にすることなく、安心してDIOボードを搭載した産業用コンピューターをお使いいただけます。

フレームグラバード搭載可能な拡張スロット

フレームグラバードボードを搭載するために必要な拡張スロット(PCI Express x4シグナル以上)を1基以上装備。

ラインナップには、PCI Express x8シグナルの拡張スロットを10基装備した製品(HMV-S612DRX-R4)があり、多数のフレームグラバードボードを必要とするご要望にもお応えすることができます。

画像処理・マシンビジョン向け産業用コンピューターの取り組み

フレームグラバード等の拡張ボード搭載、動作検証までを含めたテクニカルサポート

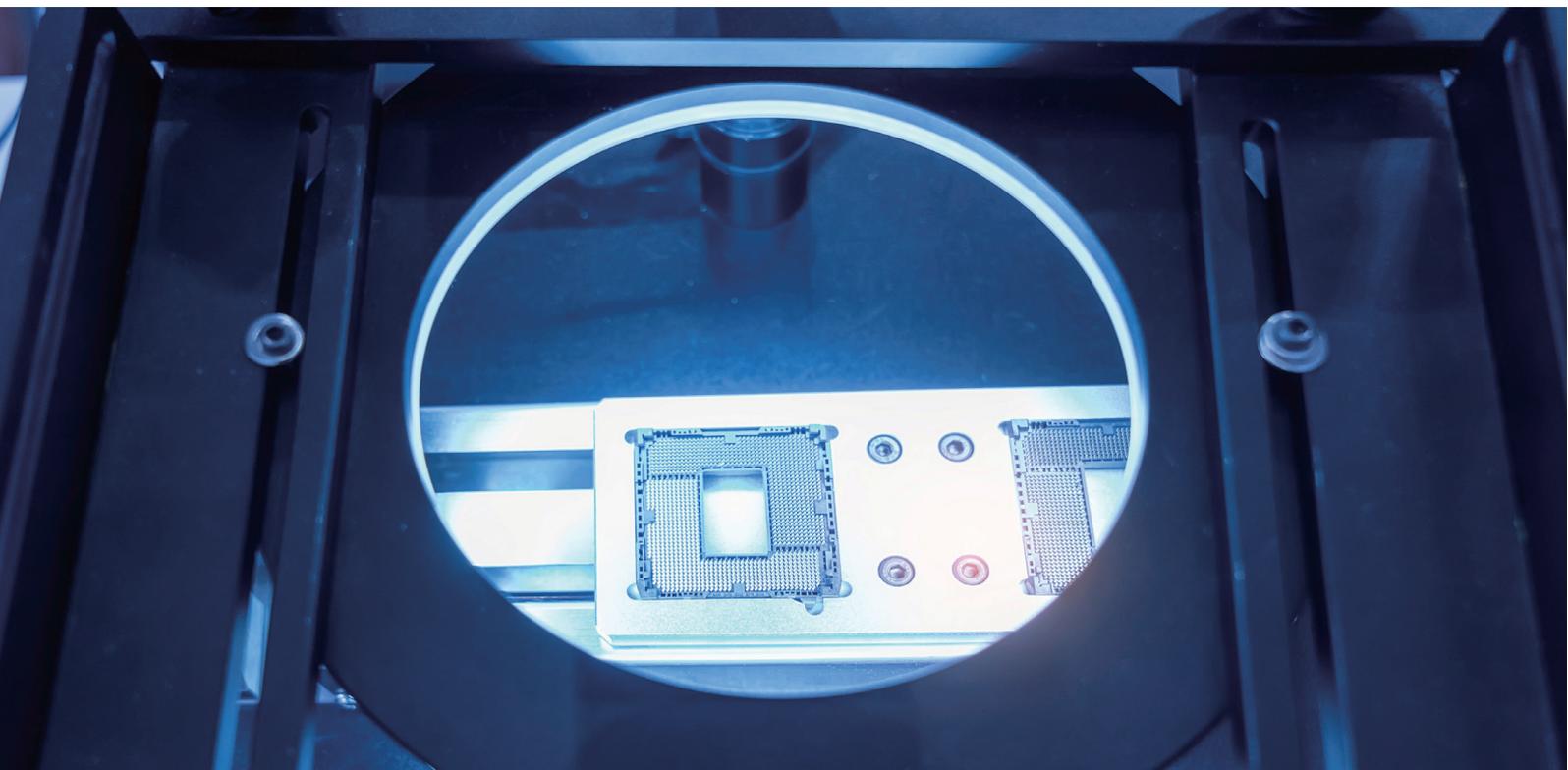
カメラで撮像した画像を産業用コンピューターに取り込む時、フレームグラバードやPoE/USB増設ボードなど拡張ボードが正しく動作する必要があります。拡張ボードメーカーにより少しずつ仕様は異なりますので、産業用コンピューターとの相性により想定した性能が出ない場合があります。HPCシステムズでは、お客様からご支給いただいた拡張ボードを産業用コンピューターに搭載し、動作検証までを含めたテクニカルサポート対応が可能です。

画像処理・マシンビジョンで広く活用されている 画像処理ライブラリ「HALCON」ベンチマークサービス

約2,000ものオペレーターを備える豊富な画像処理ライブラリ「HALCON」は、画像検査装置や位置計測等の画像処理・マシンビジョン分野で幅広く活用されています。オペレーターには画像解析や数式処理などがあり、処理方法はそれぞれ異なりますので、産業用コンピューターを仕様設計するうえで難しいことがあります。画像処理用途に求められる厳しい性能要求をクリアするための効果的な手段として、HPCシステムズのHALCONベンチマークサービスを利用することができます。

ハイスペックなコンピューターを 中長期的に安定供給

採用しているCPU、グラフィックスボード、メモリー、ストレージ・・・が仕様変更になったり、廃番・製造中止になることは珍しくありません。お客様製品の装置やシステムに支障が出ないように、HPCシステムズではパーツのロードマップ情報をいち早く入手し、検証等を行なうことで、代替品として供給することが可能です。お客様は、装置やシステムのプロダクトライフサイクルを脅かす影響を出すことなく、中長期的に安定して産業用コンピューターを入手することができます。



ハイパフォーマンス産業用コンピューター・ラインナップ

CPUの処理性能

デュアルプロセッサ

シングルプロセッサ

<p>HMV-S612SRM-TY 最大22コアのXeon® E5-2600 v4搭載可能。 スリム・ミニタワーながら優れた拡張性。</p> <ul style="list-style-type: none"> Xeon® E5-2600 v4 × 1 最大512GBメモリー (DDR4) USB3.0 × 2 LAN × 2 IPMI × 1 PCI-E (x16) シグナル Gen3 × 1 PCI-E (x8) シグナル Gen3 × 2 (空き1) M.2 × 1 W136mm × D386mm × H356mm (突起物を除く) 	<p>HMV-S612SRM-R3 最大22コアのXeon® E5-2600 v4搭載可能。 奥行きが短い約380mmの3Uラックマウント。</p> <ul style="list-style-type: none"> Xeon® E5-2600 v4 × 1 最大512GBメモリー (DDR4) USB3.0 × 2 LAN × 2 IPMI × 1 PCI-E (x16) シグナル Gen3 × 1 PCI-E (x4) シグナル Gen3 × 1 M.2 × 1 PCI W136mm × D386mm × H356mm (突起物を除く) 	<p>HMV-S612SRM-R4 低消費電力で16コアのXeon® D-1587搭載。 LAN × 6とSFP+ × 2でNetwork Appliance可能。</p> <ul style="list-style-type: none"> Xeon® D-1587 (SoC) × 1 最大128GBメモリー (DDR4) USB3.0 × 2 LAN × 6 IPMI × 1 SFP+ × 2 PCI-E (x8) シグナル Gen3 × 2 M.2 × 1 Mini PCI-E × 1 W136mm × D386mm × H356mm (突起物を除く) 	<p>HMV-S612DRX-R4 2CPU(最大44コア)のXeon® E5-2600 v4搭載可能。 最大10基のPCI-E(x8)を装備する拡張性。</p> <ul style="list-style-type: none"> Xeon® E5-2600 v4 × 2 最大2TBメモリー (DDR4) USB3.0 × 2 LAN × 2 IPMI × 1 PCI-E(x8)シグナルGen3 × 10 (空き9) PCI-E(x4)シグナルGen2 × 1 (空き0) W437mm × D525mm × H178mm (突起物を除く) 	<p>HMV-S612DAI-R4 2CPU(最大44コア)のXeon® E5-2600 v4搭載可能。 PCI-E(x16) × 最大3, PCI-E(x8) × 2の拡張性。</p> <ul style="list-style-type: none"> Xeon® E5-2600 v4 × 2 最大2TBメモリー (DDR4) USB3.0 × 4 LAN × 2 PCI-E (x16) シグナル Gen3 × 3 (空き2) PCI-E (x8) シグナル Gen3 × 2 PCI-E (x4) シグナル Gen2 × 1 (空き0) W430mm × D546mm × H176mm (突起物を除く) 	<p>HMV-S612DAI-T 2CPU(最大44コア)のXeon® E5-2600 v4搭載可能。 PCI-E(x16) × 最大3, PCI-E(x8) × 2の拡張性。</p> <ul style="list-style-type: none"> Xeon® E5-2600 v4 × 2 最大2TBメモリー (DDR4) USB3.0 × 6 (前面:2, 背面:4) LAN × 2 PCI-E (x16) シグナル Gen3 × 3 (空き2) PCI-E (x8) シグナル Gen3 × 2 PCI-E (x4) シグナル Gen2 × 1 (空き0) W193mm × D525.3mm × H424mm (突起物を除く)
<p>HMV-SD15SDV-FM 低消費電力で16コアのXeon® D-1587搭載。 スリム筐体に10GbE × 2とPCI-E(x16) × 1と装備。</p> <ul style="list-style-type: none"> Xeon® D-1587 (SoC) × 1 最大128GBメモリー (DDR4) USB3.0 × 2 LAN × 4 (10GbE × 2, 1GbE × 2) IPMI × 1 PCI-E (x16) シグナル Gen3 × 1 M.2 × 1 W328mm × D220.9mm × H88.7mm (突起物を除く) 	<p>IPC-S236SAE-TY 選べるXeon® E3-1200 v5 / 第6世代Core™。 レガシーなPCIを装備するスリム・ミニタワー。</p> <ul style="list-style-type: none"> Xeon® E3-1200 v5 / 第6世代Core™ × 1 最大64GBメモリー (DDR4) USB3.0 × 2 LAN × 2 PCI-E (x16) シグナル Gen3 × 1 PCI-E (x4) シグナル Gen3 × 1 M.2 × 1 PCI W136mm × D386mm × H356mm (突起物を除く) 	<p>HMV-S612SRL-T 最大22コアのXeon® E5-2600 v4搭載可能。 4基のPCI-E(x8)を装備するミドルタワー。</p> <ul style="list-style-type: none"> Xeon® E5-2600 v4 × 1 最大1TBメモリー (DDR4) USB3.0 × 2 LAN × 2 IPMI × 1 PCI-E(x8)シグナルGen3 × 4 PCI-E(x4)シグナルGen3 × 2 PCI-E(x4)シグナルGen2 × 1 (空き0) W198mm × D465mm × H425mm (突起物を除く) 	<p>HMV-S612SRL-R4 最大22コアのXeon® E5-2600 v4搭載可能。 4基のPCI-E(x8)を装備する4Uラックマウント。</p> <ul style="list-style-type: none"> Xeon® E5-2600 v4 × 1 最大1TBメモリー (DDR4) USB3.0 × 2 LAN × 2 IPMI × 1 PCI-E(x8)シグナルGen3 × 4 PCI-E(x4)シグナルGen3 × 2 PCI-E(x4)シグナルGen2 × 1 (空き0) W430mm × D522mm × H176 mm (突起物を除く) 	<p>IPC-S236SAT-R4 選べるXeon® E3-1200 v5 / 第6世代Core™。 レガシーなPCIを装備する4Uラックマウント。</p> <ul style="list-style-type: none"> Xeon® E3-1200 v5 / 第6世代Core™ × 1 最大64GBメモリー (DDR4) USB3.0 × 2 Thunderbolt × 1 LAN × 2 (1基はIPMIと共有) IPMI × 1 = LANと共有 PCI-E(x16)シグナルGen3 × 1 PCI-E(x8)シグナルGen3 × 2 PCI-E(x4)シグナルGen3 × 1 PCI × 1 W430mm × D522mm × H176 mm (突起物を除く) 	

省スペース / コストパフォーマンス 重視

拡張性 / 高性能 重視

ボックス型コンピューター・ラインナップ

CPUの処理性能

<p>ECS-9200/9100 GTX 1050 Series NVIDIA® GeForce® GTX 1050Ti/1050, 第7世代Core™/Xeon® E3プロセッサ搭載。</p> <ul style="list-style-type: none"> 第7世代Core™ / Xeon® × 1 最大32GBメモリー (DDR4) USB3.0 × 8 COM × 4 LAN × 2 PoE × 4 @ ECS-9200 W260mm × D215mm × H79mm (突起物を除く) 最大-20℃ ~ +60℃ 10V~36Vまでサポート 	<p>RCS-9440 PCI-E (x8) × 1, PCI-E (x4) × 3, USB3.0 × 6を装備。 低消費電力タイプの第6世代Core™を搭載。</p> <ul style="list-style-type: none"> 第6世代Core™ × 1 最大32GBメモリー (DDR4) USB3.0 × 6 COM × 4 LAN × 2 PCI-E (x8) × 1 PCI-E (x4) × 3 W172mm × D250mm × H210mm (突起物を除く) 最大-25℃ ~ +75℃ 6V~36Vまでサポート
<p>SPC-2900 Series 手のひらサイズに収まるコンパクトさ。 USB3.0 × 4はポート毎に独立したコントローラ[®]。 <small>※SPC2900Lに付属したUSB3.0のポートのうち4ポート分</small></p> <ul style="list-style-type: none"> Celeron® J1900 × 1 最大8GBメモリー (DDR3L) USB3.0 × 最大7 COM × 4 LAN × 2 W106mm × D150mm × H91mm (突起物を除く) 最大-25℃ ~ +70℃ 6V~36Vまでサポート 	<p>EAGLE-8701 スリムな筐体にPoE × 6, USB3.0 × 6を装備。 低消費電力タイプの第4世代Core™を搭載。</p> <ul style="list-style-type: none"> 第4世代Core™ × 1 最大16GBメモリー (DDR3L) USB3.0 × 6 LAN × 2 PoE × 6 PCI-E (x16) × 1 (10ポート用) W90mm × D230mm × H285mm (突起物を除く) 最大-10℃ ~ +55℃ DC 24V input
<p>SPC-2845 手のひらサイズに収まるコンパクトさ。 USB3.0 × 4, PoE × 2を装備する拡張性。</p> <ul style="list-style-type: none"> Atom™ E3845 × 1 最大8GBメモリー (DDR3L) USB3.0 × 4 PoE × 2 W106mm × D150mm × H66mm (突起物を除く) 最大-25℃ ~ +70℃ 6V~36Vまでサポート 	

コンパクト / 温度拡張 重視 ※拡張ボード搭載時、温度拡張はありません

ご要求に応じたカスタマイズは小ロットから可能

画像処理・マシンビジョンに特化した HPCシステムズ株式会社 CTO事業について

HPCシステムズは2006年に誕生した、産業向けコンピュータとハイパフォーマンスコンピューティングのトータルサービスプロバイダーです。

CTO事業は、前身企業から数えて約30年間の経験と実績がある産業向けのハードウェアソリューションメーカーです。開発・検証、生産、アフターサポートまでを国内体制で対応しています。高速処理や安定動作が求められるマシンビジョン分野において、HPCシステムズは最適なコンピュータをご提供しています。

取扱い製品

カスタマイズ
コンピューター

ボックス型コンピューター

サーバー

ワークステーション

パネルコンピューター

タブレット

ネットワークスイッチ

周辺機器
パーツ製品

■会社概要

商号 HPCシステムズ株式会社 (HPC Systems Inc.)
 設立 2006年(平成18年)7月3日
 資本金 1億5300万円
 社員数 83名(2017年3月24日現在)
 所在地 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
 役員 代表取締役 小野 鉄平
 取締役 HPC事業部長 長谷川 真樹
 取締役 CTO事業部長 関 浩行
 取締役 HPC事業部営業統括 齋藤 正保
 事業 CTO事業 (Configure To Order事業)
 HPC事業 (High Performance Computer事業)



本社(CTO営業) 〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
 西日本営業所 〒600-8412 京都府京都市下京区烏丸通綾小路下二帖半敷町
 646 ダイマルヤ四条丸ビル5F-B
 とうさ 匝 瑛 工場 〒289-3181 千葉県匝瑛市野手174-1
 台湾開発センター 5F, No.1, Alley 6, Lane 235, Boa Chiao Road, Hsin Tien City,
 Taipei Taiwan, R.O.C. (台北縣新店市寶橋路235巷6弄1號5樓)

U R L : <http://embe.hpc.co.jp/>
 M a i l : hpcs_sales@hpc.co.jp
 T E L : 03-5446-5535



Technology
Provider
Gold 2017



JVAC-EM0320 (ISO14001 認証取得)
 登録事業所: 本社・理工工場
 JVAC-QM0723 (ISO9001 認証取得)
 登録事業部: CTO事業部



会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2018年9月19日 現在の内容です。